

## ジャパン半導体株式ファンド

## 運用報告書（全体版）

第1期（決算日 2024年12月20日）

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

「ジャパン半導体株式ファンド」は、2024年12月20日に第1期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

## 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式	
信託期間	2023年12月22日から原則無期限です。	
運用方針	主として、「ジャパン半導体株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主要運用対象	ジャパン半導体株式ファンド	「ジャパン半導体株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	ジャパン半導体株式マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	ジャパン半導体株式ファンド	株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	ジャパン半導体株式マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
分配方針	毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。	

## 日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号  
www.nikkoam.com/

2025年9月1日、日興アセットマネジメント株式会社は「アモヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更します。  
社名変更後URL: [www.amova-am.com](http://www.amova-am.com)

&lt;645105&gt;

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404  
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			株組 入比率	式率	純資 産額
		税分	込配	み期 金騰 落			
(設定日)	円		円		%		百万円
2023年12月22日	10,000		—		—		1,481
1期(2024年12月20日)	10,646		0	6.5	97.5		8,701

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) ファンドの商品性格に適合する適切なベンチマークおよび参考指数はございません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準	価額		株組 入比率	式率
		騰	落率		
(設定日)	円		%		%
2023年12月22日	10,000		—		—
12月末	10,104		1.0		95.7
2024年1月末	10,816		8.2		96.1
2月末	11,964		19.6		96.5
3月末	12,519		25.2		95.7
4月末	11,999		20.0		95.5
5月末	12,219		22.2		96.3
6月末	12,495		25.0		97.2
7月末	11,758		17.6		97.4
8月末	11,017		10.2		96.4
9月末	10,808		8.1		96.4
10月末	11,191		11.9		96.9
11月末	10,515		5.2		96.5
(期末)					
2024年12月20日	10,646		6.5		97.5

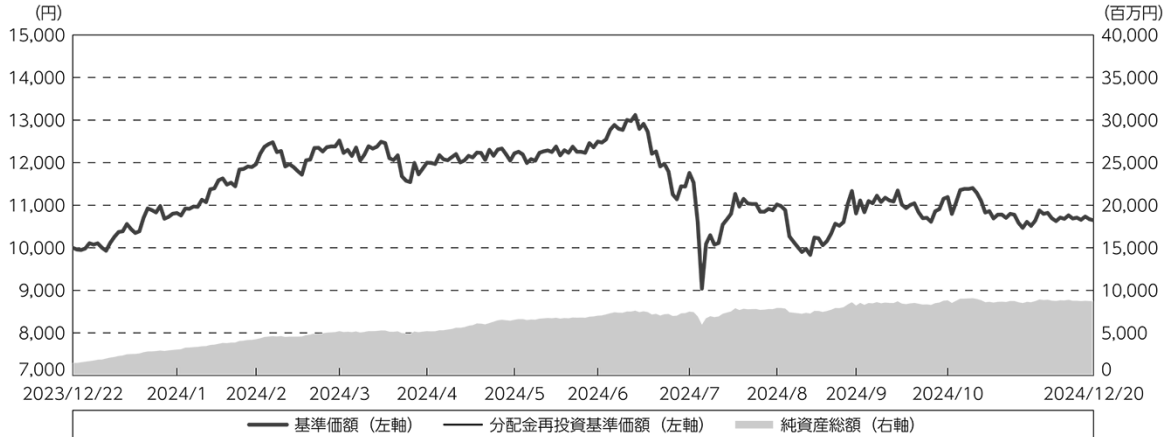
(注) 騰落率は設定日比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

○運用経過

(2023年12月22日～2024年12月20日)

期中の基準価額等の推移



設定日：10,000円

期 末：10,646円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 6.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)の中から、半導体に関連するビジネスを行なう企業の株式に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。信託期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・国内企業の好調な業績を受けて海外の投資家が日本株式への関心を高めていたこと。
- ・米国の大手半導体企業の好決算などを背景として半導体関連の銘柄を中心にハイテク株が堅調だったこと。
- ・米国連邦準備制度理事会(FRB)が利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待感が強まったこと。
- ・「アドバンテスト」、「荏原製作所」、「ソシオネクスト」などの保有銘柄の株価が上昇したこと。

<値下がり要因>

- ・米国による新たな対中国輸出規制の懸念が再燃したこと。
- ・日銀が金融政策決定会合において利上げを決定したことなどをを受けて円高／アメリカドル安が一時進み、輸出関連企業の業績への期待が後退したこと（2024年7月上旬から9月上旬）。
- ・米国の製造業の景況感や雇用に関する経済指標が市場予想を下回り、米国景気の減速懸念が強まったこと（2024年8月上旬）。
- ・「イビデン」、「SUMCO」、「SCREENホールディングス」などの保有銘柄の株価が下落したこと。

## 投資環境

(株式市況)

国内株式市場では、主要な株価指数は期間の初めと比べて上昇しました。

中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、日銀が金融政策決定会合において利上げを決定したことなどをを受けて円高／アメリカドル安が一時進み、輸出関連企業の業績への期待が後退したこと、米国の製造業の景況感や雇用に関する経済指標が市場予想を下回り、米国景気の減速懸念が強まったことなどから株価が下落する局面があったものの、国内企業の好調な業績を受けて海外の投資家が日本株式への関心を高めていたことや、FRBが利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待感が強まったこと、日銀総裁の金融政策決定会合後の記者会見での発言から早期の追加利上げ観測が後退したこと、FRB議長が講演で米国経済が総じて堅調との認識を示したことなどが株価の支援材料となり、国内の主要な株価指数は上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

(当ファンド)

当ファンドは、「ジャパン半導体株式マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。

(ジャパン半導体株式マザーファンド)

当ファンドは、拡大する半導体需要を支える日本の半導体関連産業を、①半導体の製造にかかわる企業、②半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業、③国内半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺企業という3つの投資カテゴリーで捉え投資を行ないます。

期間中は、主に中長期で高い成長が期待できる後工程関連企業に投資をしました。また、期中では短期的に割安度が増した半導体製造装置、半導体材料、半導体工場関連の銘柄への投資も行ないました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

## 分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第 1 期
	2023年12月22日～ 2024年12月20日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	646

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

### ○今後の運用方針

(当ファンド)

引き続き、ファンドの基本方針に則り、「ジャパン半導体株式マザーファンド」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。

(ジャパン半導体株式マザーファンド)

A I (人工知能) 関連を中心とした半導体市場に対する成長期待は引き続き高く、中長期的には自動車の自動運転・電動化、I o T (モノのインターネット) の拡大に伴う高い成長も見込まれます。また、今後成長が見込まれる高性能半導体分野では微細化だけでなくパッケージの高度化など後工程技術の進化による性能向上が求められています。日本には後工程に強みを持つ半導体関連企業も多く、後工程技術の進化に伴ない高い成長が期待されます。

加えて、日本では政府からの補助金の後押しもあり大規模な半導体工場の建設や、半導体工場建設に伴う周辺産業の活性化も見込まれています。

ポートフォリオの構築においては、この拡大する半導体需要を支える日本の半導体関連産業を、①半導体の製造にかかわる企業、②半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業、③国内半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺企業という3つの投資カテゴリーで捉え投資を行なう方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月22日～2024年12月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	181	1.580	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 88 )	( 0.768 )	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	( 88 )	( 0.768 )	運用報告書など各種書類の送付、口内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	( 5 )	( 0.044 )	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	17	0.152	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 17 )	( 0.152 )	
(c) そ の 他 費 用	6	0.049	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 1 )	( 0.004 )	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ 印 刷 費 用 等 ）	( 5 )	( 0.045 )	印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用、運用において利用する指数の 標章使用料など
合 計	204	1.781	
期中の平均基準価額は、11,450円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

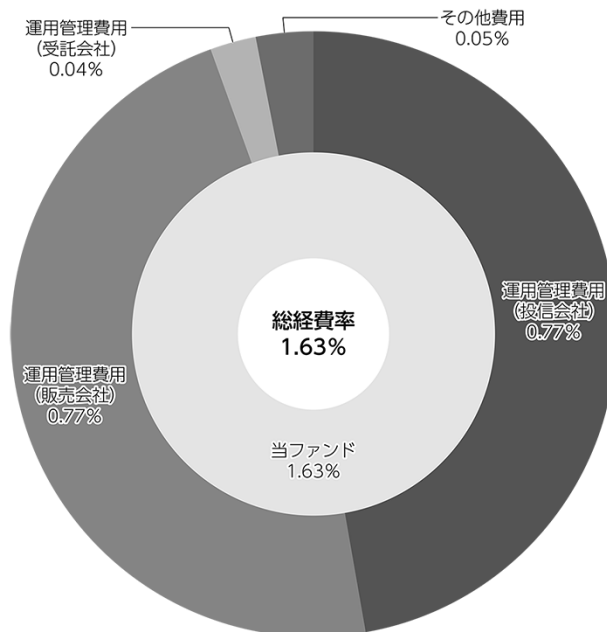
(注) 売買委託手数料は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.63%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年12月22日～2024年12月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
ジャパン半導体株式マザーファンド	8,168,715千口	9,102,434千円	248,068千口	286,866千円

○株式売買比率

(2023年12月22日～2024年12月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	ジャパン半導体株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	11,063,624千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,966,724千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.85

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年12月22日～2024年12月20日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年12月22日～2024年12月20日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年12月22日～2024年12月20日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年12月20日現在)

親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		口 数	評 価 額
		千口	千円
ジャパン半導体株式マザーファンド		7,920,647	8,589,942

(注) 親投資信託の2024年12月20日現在の受益権総口数は、7,920,647千口です。

○投資信託財産の構成

(2024年12月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ジャパン半導体株式マザーファンド	8,589,942	97.3
コール・ローン等、その他	238,800	2.7
投資信託財産総額	8,828,742	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年12月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,828,742,873
コール・ローン等	212,127,749
ジャパン半導体株式マザーファンド(評価額)	8,589,942,620
未収入金	26,671,130
未収利息	1,374
(B) 負債	127,376,746
未払解約金	61,665,146
未払信託報酬	62,743,855
その他未払費用	2,967,745
(C) 純資産総額(A-B)	8,701,366,127
元本	8,173,242,970
次期繰越損益金	528,123,157
(D) 受益権総口数	8,173,242,970口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,646円

(注) 当ファンドの設定時元本額は1,481,645,281円、期中追加設定元本額は7,912,719,167円、期中一部解約元本額は1,221,121,478円です。

(注) 1口当たり純資産額は1.0646円です。

○損益の状況 (2023年12月22日～2024年12月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	212,104
受取利息	212,947
支払利息	△ 843
(B) 有価証券売買損益	△277,034,046
売買益	22,871,476
売買損	△299,905,522
(C) 信託報酬等	△101,027,117
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	△377,849,059
(E) 追加信託差損益金	905,972,216
(配当等相当額)	(△ 926)
(売買損益相当額)	( 905,973,142)
(F) 計(D+E)	528,123,157
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	528,123,157
追加信託差損益金	905,972,216
(配当等相当額)	( 10,499,323)
(売買損益相当額)	( 895,472,893)
分配準備積立金	6,413,947
繰越損益金	△384,263,006

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2023年12月22日～2024年12月20日)は以下の通りです。

項 目	2023年12月22日～ 2024年12月20日
a. 配当等収益(経費控除後)	6,413,947円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	521,709,210円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	528,123,157円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	646円
g. 分配金	0円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

## ○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	0円
------------------	----

## ○お知らせ

### 約款変更について

2023年12月22日から2024年12月20日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

### その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「[www.amova-am.com](http://www.amova-am.com)」へ変更となります。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

# ジャパン半導体株式マザーファンド

## 運用報告書

第1期（決算日 2024年12月20日）  
（2023年12月22日～2024年12月20日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2023年12月22日から原則無期限です。
運用方針	主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

## ファンド概要

主として、わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）の中から、半導体に関連するビジネスを行なう企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。株式の組入比率は、高位を維持することを基本とし、銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性などを勘案して行ないます。

株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	騰 落 率		株 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰	中 率		
(設定日)	円		%	%	百万円
2023年12月22日	10,000	—	—	—	1,444
1期(2024年12月20日)	10,845	8.5		98.8	8,590

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) ファンドの商品性格に適合する適切なベンチマークおよび参考指数はございません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株 組 入 比 率
		騰	落	
(設定日)	円		%	%
2023年12月22日	10,000	—	—	—
12月末	10,110		1.1	98.1
2024年1月末	10,857		8.6	98.5
2月末	12,056		20.6	98.9
3月末	12,647		26.5	98.2
4月末	12,125		21.3	97.9
5月末	12,369		23.7	97.8
6月末	12,669		26.7	98.6
7月末	11,926		19.3	98.5
8月末	11,175		11.8	97.8
9月末	10,974		9.7	98.0
10月末	11,387		13.9	98.4
11月末	10,699		7.0	98.0
(期 末)				
2024年12月20日	10,845		8.5	98.8

(注) 騰落率は設定日比です。

○運用経過

(2023年12月22日～2024年12月20日)

基準価額の推移

設定時10,000円の基準価額は、期間末に10,845円となり、騰落率は+8.5%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・国内企業の好調な業績を受けて海外の投資家が日本株式への関心を高めていたこと。
- ・米国の大手半導体企業の好決算などを背景として半導体関連の銘柄を中心にハイテク株が堅調だったこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待感が強まったこと。
- ・「アドバンテスト」、「荏原製作所」、「ソシオネクスト」などの保有銘柄の株価が上昇したこと。

<値下がり要因>

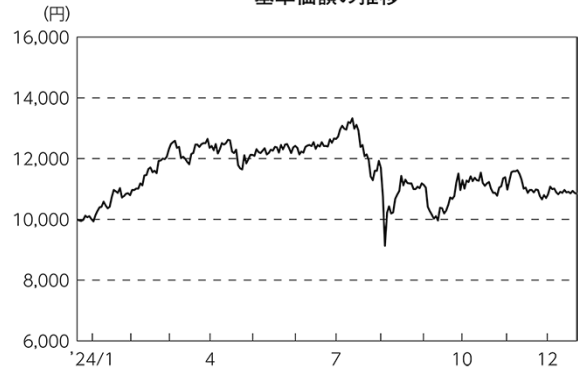
- ・米国による新たな対中国輸出規制の懸念が再燃したこと。
- ・日銀が金融政策決定会合において利上げを決定したことなどをを受けて円高／アメリカドル安が一時進み、輸出関連企業の業績への期待が後退したこと（2024年7月上旬から9月上旬）。
- ・米国の製造業の景況感や雇用に関する経済指標が市場予想を下回り、米国景気の減速懸念が強まったこと（2024年8月上旬）。
- ・「イビデン」、「SUMCO」、「SCREENホールディングス」などの保有銘柄の株価が下落したこと。

(株式市況)

国内株式市場では、主要な株価指数は期間の初めと比べて上昇しました。

中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、日銀が金融政策決定会合において利上げを決定したことなどをを受けて円高／アメリカドル安が一時進み、輸出関連企業の業績への期待が後退したこと、米国の製造業の景況感や雇用に関する経済指標が市場予想を下回り、米国景気の減速懸念が強まったことなどから株価が下落する局面があったものの、国内企業の好調な業績を受けて海外の投資家が日本株式への関心を高めていたことや、FRBが利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待感が強まったこと、日銀総裁の金融政策決定会合後の記者会見での発言から早期の追加利上げ観測が後退したこと、FRB議長が講演で米国経済が総じて堅調との認識を示したことなどが株価の支援材料となり、国内の主要な株価指数は上昇しました。

基準価額の推移



設定時	期中高値	期中安値	期 末
2023/12/22	2024/07/11	2024/08/05	2024/12/20
10,000円	13,319円	9,133円	10,845円

## ポートフォリオ

当ファンドは、拡大する半導体需要を支える日本の半導体関連産業を、①半導体の製造にかかわる企業、②半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業、③国内半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺企業という3つの投資カテゴリーで捉え投資を行ないます。

期間中は、主に中長期で高い成長が期待できる後工程関連企業に投資をしました。また、期中では短期的に割安度が増した半導体製造装置、半導体材料、半導体工場関連の銘柄への投資も行ないました。

## ○今後の運用方針

AI（人工知能）関連を中心とした半導体市場に対する成長期待は引き続き高く、中長期的には自動車の自動運転・電動化、IoT（モノのインターネット）の拡大に伴う高い成長も見込まれます。また、今後成長が見込まれる高性能半導体分野では微細化だけでなくパッケージの高度化など後工程技術の進化による性能向上が求められています。日本には後工程に強みを持つ半導体関連企業も多く、後工程技術の進化に伴ない高い成長が期待されます。

加えて、日本では政府からの補助金の後押しもあり大規模な半導体工場の建設や、半導体工場建設に伴う周辺産業の活性化も見込まれています。

ポートフォリオの構築においては、この拡大する半導体需要を支える日本の半導体関連産業を、①半導体の製造にかかわる企業、②半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業、③国内半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺企業という3つの投資カテゴリーで捉え投資を行なう方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月22日～2024年12月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 )	円 18 (18)	% 0.155 (0.155)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
合 計	18	0.155	
期中の平均基準価額は、11,582円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○ 売買及び取引の状況

(2023年12月22日～2024年12月20日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		2,574 ( 404)	9,940,492 ( -)	421	1,123,132

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○ 株式売買比率

(2023年12月22日～2024年12月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	11,063,624千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,966,724千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.85

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年12月22日～2024年12月20日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年12月22日～2024年12月20日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年12月20日現在)

国内株式

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
<b>建設業 (9.0%)</b>		
鹿島建設	109.4	307,195
関電工	119.9	283,803
高砂熱学工業	14.4	92,678
大気社	16	77,280
<b>化学 (12.9%)</b>		
信越化学工業	41.8	211,257
四国化成ホールディングス	55	110,385
三菱瓦斯化学	63.7	172,021
三井化学	9.6	31,987
東京応化工業	35.5	124,392
積水化学工業	57	135,375
扶桑化学工業	58.9	204,972
トリケミカル研究所	38.3	105,746
<b>ガラス・土石製品 (2.1%)</b>		
日東紡績	28.7	178,227
<b>金属製品 (1.2%)</b>		
SUMCO	94.7	106,111
<b>機械 (24.7%)</b>		
ディスコ	7.3	303,242
A Iメカテック	38.3	117,772
野村マイクロ・サイエンス	49.5	78,309
SMC	1.4	85,806
小松製作所	14.4	59,932
TOWA	63.3	89,316
ローツェ	107.4	162,388
荏原製作所	176.4	447,350
オルガノ	40.2	326,424
ダイフク	46.7	156,912
CKD	93.5	230,758
カナデビア	45.2	41,810
<b>電気機器 (37.6%)</b>		
イビデン	94.9	414,048
ミネベアミツミ	24.1	60,250

銘柄	当 期 末		
	株 数	評 価 額	
	千株	千円	
シンフォニアテクノロジー	28.5	191,235	
KOKUSAI ELECTRIC	14.9	31,491	
ソシオネクスト	35.9	94,901	
芝浦メカトロニクス	45.6	351,576	
ルネサスエレクトロニクス	95.3	193,411	
アルバック	19.9	120,454	
ソニーグループ	68.5	224,954	
堀場製作所	21.5	194,424	
アドバンテスト	55.5	477,799	
レーザーテック	2.7	39,960	
エンプラス	21.3	102,666	
ローム	11.8	16,626	
村田製作所	9.4	22,936	
S C R E E Nホールディングス	25.5	236,589	
東京エレクトロン	17.9	417,070	
<b>輸送用機器 (1.8%)</b>			
デンソー	42.6	87,330	
ヤマハ発動機	44.5	62,211	
<b>精密機器 (0.6%)</b>			
HOYA	2.7	52,731	
<b>その他製品 (2.0%)</b>			
TOPPANホールディングス	44.7	172,318	
<b>情報・通信業 (0.3%)</b>			
日本電信電話	152.8	23,775	
<b>卸売業 (7.6%)</b>			
マクニカホールディングス	103.9	179,175	
長瀬産業	84.7	266,889	
豊田通商	32.4	85,698	
キャノンマーケティングジャパン	21.4	109,182	
<b>サービス業 (0.2%)</b>			
ジャパンマテリアル	8.4	13,641	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,557	8,484,801
	銘柄数<比率>	53	<98.8%>

(注) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。  
 (注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2024年12月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	8,484,801	97.8
コール・ローン等、その他	193,067	2.2
投資信託財産総額	8,677,868	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年12月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,677,868,799
コール・ローン等	129,465,251
株式(評価額)	8,484,801,180
未収入金	63,601,529
未収利息	839
(B) 負債	87,630,717
未払金	60,959,587
未払解約金	26,671,130
(C) 純資産総額(A-B)	8,590,238,082
元本	7,920,647,875
次期繰越損益金	669,590,207
(D) 受益権総口数	7,920,647,875口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,845円

(注) 当ファンドの設定時元本額は1,444,604,148円、期中追加設定元本額は6,724,111,845円、期中一部解約元本額は248,068,118円です。

(注) 2024年12月20日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・ジャパン半導体株式マザーファンド 7,920,647,875円

(注) 1口当たり純資産額は1.0845円です。

○損益の状況 (2023年12月22日～2024年12月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	107,228,960
受取配当金	107,047,650
受取利息	183,948
その他収益金	1
支払利息	△ 2,639
(B) 有価証券売買損益	△ 332,559,143
売買益	973,466,206
売買損	△1,306,025,349
(C) 当期損益金(A+B)	△ 225,330,183
(D) 追加信託差損益金	933,718,431
(E) 解約差損益金	△ 38,798,041
(F) 計(C+D+E)	669,590,207
次期繰越損益金(F)	669,590,207

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 損益の状況の中で(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

## ○お知らせ

---

### 約款変更について

2023年12月22日から2024年12月20日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

### その他の変更について

日興アセットマネジメント株式会社は、2025年9月1日よりアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に社名変更します。また、ホームページアドレスも「[www.amova-am.com](http://www.amova-am.com)」へ変更となります。